

国泰海通证券股份有限公司

关于北京屹唐半导体科技股份有限公司

2025 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：屹唐股份
保荐代表人姓名：魏鹏、吴同欣	被保荐公司代码：688729.SH

重大事项提示

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]467号）批复，北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票 29,556.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.45 元，募集资金总额为人民币 249,748.20 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 234,286.73 万元。本次发行证券已于 2025 年 7 月 8 日在上海证券交易所上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2025 年 7 月 8 日至 2028 年 12 月 31 日。

在 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就本持续督导期间持续督导情况报告如下：

一、2025 年保荐机构持续督导工作情况

项目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息

项目	工作内容
及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续督导工作。	披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续督导工作。
2、根据上市规则规定，与公司就持续督导期间的权利义务签订持续督导协议。	保荐机构已与上市公司签署了持续督导协议，明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3、协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。	保荐机构已协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。
4、持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。	保荐机构已持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
5、对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。	保荐机构已对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。
6、督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。	保荐机构已督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。
7、上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。 保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。 上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。	本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。 上市公司或其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。
8、督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。	保荐机构已督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。
9、持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项，核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。	保荐机构已持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况。本持续督导期间，上市公司不存在应披露而未披露的重大风险或者重大负面事项。

项目	工作内容
<p>10、重点关注上市公司是否存在如下事项：</p> <p>（一）存在重大财务造假嫌疑；</p> <p>（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；</p> <p>（三）可能存在重大违规担保；</p> <p>（四）资金往来或者现金流存在重大异常；</p> <p>（五）上交所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。</p> <p>出现上述情形的，保荐机构及其保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内按规定进行专项现场核查，并在现场核查结束后 15 个交易日内披露现场核查报告。</p>	<p>本持续督导期内，上市公司未出现该等事项。</p>
<p>11、关注上市公司股票交易严重异常波动情况，督促上市公司及时按照上市规则履行信息披露义务。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>12、上市公司日常经营出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露：</p> <p>（一）主要业务停滞或出现可能导致主要业务停滞的重大风险事件；</p> <p>（二）资产被查封、扣押或冻结；</p> <p>（三）未能清偿到期债务；</p> <p>（四）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；</p> <p>（五）涉及关联交易、为他人提供担保等重大事项；</p> <p>（六）交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。</p>	<p>本持续督导期间，保荐机构已根据法规要求，及时对上市公司关联交易等应当发表意见的事项出具核查意见并披露。</p>
<p>13、上市公司业务和技术出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司核心竞争力和日常经营的影响，以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露：</p> <p>（一）主要原材料供应或者产品销售出现重大不利变化；</p> <p>（二）核心技术人员离职；</p> <p>（三）核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可丧失、不能续期或者出现重大纠纷；</p> <p>（四）主要产品研发失败；</p> <p>（五）核心竞争力丧失竞争优势或者市场出现具有明显优势的竞争者；</p> <p>（六）交易所或者保荐机构认为应当发表意见</p>	<p>本持续督导期间，保荐机构已根据法规要求，及时对上市公司核心技术人员变动等应当发表意见的事项出具核查意见并披露。</p>

项目	工作内容
的其他情形。	
<p>14、控股股东、实际控制人及其一致行动人出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对上市公司控制权稳定和日常经营的影响、是否存在侵害上市公司利益的情形以及其他未披露重大风险发表意见并披露：</p> <p>（一）所持上市公司股份被司法冻结；</p> <p>（二）质押上市公司股份比例超过所持股份80%或者被强制平仓的；</p> <p>（三）上交所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>15、督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。</p>	<p>保荐机构已督促控股股东、实际控制人、董事、监事（取消监事会前的监事）、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，持续关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。</p>
<p>16、持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项，对募集资金存放与使用情况进行现场检查。</p>	<p>保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议，于2026年3月31日对上市公司募集资金存放与使用情况进行了现场检查，并出具关于募集资金存放与使用情况的专项核查报告。</p>
<p>17、保荐机构发表核查意见情况。</p>	<p>2025年度，保荐机构发表核查意见具体情况如下：</p> <p>2025年7月25日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于北京屹唐半导体科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》《国泰海通证券股份有限公司关于北京屹唐半导体科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》《国泰海通证券股份有限公司关于北京屹唐半导体科技股份有限公司调整部分高级管理人员、核心技术人员的核查意见》；</p> <p>2025年11月24日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于北京屹唐半导体科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》；</p> <p>2025年12月26日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股</p>

项目	工作内容
	份上市流通的核查意见》。
18、保荐机构发现的问题及整改情况（如有）	无

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐机构开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、核心技术泄密的风险

半导体设备行业是典型的技术密集型行业，核心技术系公司的核心竞争力体现。一旦核心技术失密，将可能使公司完全或部分丧失技术竞争优势，可能给公司市场竞争力和生产经营带来负面影响。

2、知识产权争议风险

半导体设备行业是典型的技术密集型行业，为了保持技术优势和竞争力，防止技术外泄风险，已掌握先进技术的半导体设备企业通常会通过申请专利等方式设置较高的进入壁垒。公司存在与竞争对手产生知识产权纠纷的风险，届时可能需要通过法律诉讼等方式维护自身权益，由此可能需承担较高的法律和经济成本，将对公司的生产经营造成不利影响。同时，专利、商标等知识产权保护与侵权风险可能会随着公司产品线的不断丰富而增加。

公司在全球范围内销售产品，在多个国家或地区注册知识产权，不同国家、不同的法律体系对知识产权的权利范围的解释和认定存在差异，若未能深刻理解这些差异可能会引发争议甚至诉讼，并随之影响生产经营。此外，公司供应商和客户的日常经营也可能受知识产权争议、诉讼等因素影响，进而间接影响公司正常的生产经营。

3、核心研发人员流失或不足的风险

伴随市场需求的不断增长和行业竞争的日益激烈，半导体设备行业对于专业技术人才的竞争不断加剧。如果未来公司不能提供更好的发展平台、更具市场竞争力的薪酬待遇及良好的研发条件，可能面临核心研发人员流失的风险；同时，公司经营规模持续扩张，若公司人才不能满足营业规模增长对持续技术研发的需求，公司将面临核心研发人员不足的风险。

（二）经营风险

1、与国际龙头在产品线覆盖广度存在较大差距的风险

在集成电路设备领域，应用材料、泛林半导体、东京电子等国际龙头成立时间长，且北美、欧洲、日韩等地区半导体市场发展程度更高，国际龙头产品线布局相对完善。应用材料产品覆盖领域包括等离子体刻蚀、单晶圆热处理、化学气相薄膜沉积、物理气相薄膜沉积、外延薄膜沉积、离子注入、检测等；泛林半导体、东京电子等在等离子体刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗、显影、检测等领域拥有较为成熟的产品组合。公司主要产品包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀及等离子体表面处理设备在内的三类集成电路设备。

更广泛的产品线覆盖程度可以使得集成电路设备制造企业为客户提供更为全面、综合的产品及服务。现阶段，公司产品线覆盖广度上与上述国际巨头尚存在一定差距，公司在行业内的综合竞争力与国际龙头企业相比仍存在不足。

2、客户集中度较高的风险

公司为全球范围内的集成电路制造厂商提供集成电路制造设备及配套工艺解决方案，集成电路制造行业具有企业规模大、数量少的特征，公司的客户集中度较高。如果公司主要客户生产经营情况恶化、资本性支出下降，导致其向公司下达的订单数量下降，则可能对公司的业绩稳定性产生影响。此外，如果公司无法维护与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入，亦将可能对公司经营业绩产生不利影响。

（三）财务风险

1、商誉减值风险

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中商誉的账面价值为 96,473.73 万元，占报告期末净资产比例为 10.82%，主要系公司 2016 年收购美国子公司 MTI 所产生。若未来宏观经济、政治环境、市场条件、产业政策或其他不可抗力等外部因素发生重大不利变化，导致公司经营业绩下降，可能使公司面临商誉减值的风险。

2、汇率波动风险

报告期内，公司的大多数产品销售以美元计价，部分原材料和零部件采购、员工薪酬等以美元、欧元、韩元、日元等计价，人民币对上述外币的汇率波动将会对公司的经营成果造成影响。人民币汇率随着国际政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。报告期内，公司财务费用中汇兑损失的金额为 472.17 万元。随着公司业务规模的持续扩大，若未来人民币对美元、欧元等外币的汇率发生剧烈波动，可能产生汇兑损益及外币报表折算差异，从而可能对公司的经营成果和财务状况造成不利影响。

3、税收政策变动风险

报告期内公司享受高新技术企业税收优惠，企业所得税减按 15% 的税率征收。如果国家相关的法律法规发生变化，或其他原因导致公司不再符合相关的税收优惠认定或鼓励条件，则公司的经营业绩将可能受到不利影响。

此外，公司还在美国、德国、韩国、新加坡等多个国家或地区开展业务，不同税收司法管辖区的税收政策可能会发生变动。如果境外税收政策发生不利变动，公司的经营业绩也可能受到不利影响。

（四）行业风险

1、市场竞争风险

伴随集成电路产业的快速发展，良好的发展前景吸引诸多国内企业进入这一领域，并且，国内半导体设备上市企业也纷纷扩展设备品类，形成新的竞争格局，国内市场竞争加剧；同时以应用材料、泛林半导体、东京电子为代表的国际集成电路制造设备巨头较早进入市场，并在巩固自身优势基础上积极进行技术升级，产品具备较强的市场竞争力。

若公司不能根据客户需求及时进行技术和产品创新，则可能对公司的行业地位、市场份额、经营业绩等产生不利影响。

2、技术升级迭代的风险

公司所处的半导体设备行业属于技术密集型行业，半导体设备的研发涉及微电子、电气、机械、材料、化学工程、流体力学、自动化、通讯、软件系统等众多学科领域，具有较高的技术研发门槛。伴随下游应用领域发展日新月异，半导体产品的性能需不断更新迭代。如果公司不能紧跟国内外半导体设备制造技术的发展趋势，不能持续加强技术研发和技术人才队伍的建设，可能导致公司无法实现技术水平的提升，在未来的市场竞争中处于劣势，届时公司将面临因无法保持持续创新能力而导致市场竞争力下降的风险。

（五）宏观环境风险

1、宏观经济和行业波动风险

半导体设备行业受宏观经济、下游半导体市场及终端消费需求波动的影响，其发展往往呈现一定的周期性。如果宏观经济发生剧烈波动，半导体行业进入景气度下行周期，或消费电子、数据中心、计算机、网络通信等终端市场需求下降，半导体制造厂商将面临产能过剩的局面，通常会削减资本性支出和对半导体设备的采购金额，将可能会对公司的业务发展和经营业绩造成不利影响。

如果宏观经济向好，半导体行业进入景气度提升周期，且终端市场需求上升，则景气度传导至半导体设备行业，公司也需扩大产能，以满足预期的客户需求。如果公司不能及时有效地应对客户需求的快速增长，或者在客户需求增长趋势下做出客户需求减少的错误判断，可能会导致公司失去潜在客户，进而对公司的业务发展和经营业绩造成不利影响。

2、贸易摩擦风险

公司在中国、美国、德国、韩国、日本等多个国家或地区开展业务，2024年12月，公司被美国商务部列入“实体清单”。本次实体清单事项对公司获取受美国《出口管制条例》管辖的物项带来一定限制。公司通过积极推进供应链多元化、本土化策略、战略库存及前瞻性备货等多种举措保障了供应链的安全性和稳定性。

如果未来相关国家及地区采取更为严苛的限制或制裁措施，公司可能面临与上下游合作伙伴继续合作受限、供应链稳定性受到影响等风险，公司下游客户新产线扩张进程也可能因此出现放缓进而导致需求削减，从而对公司经营发展产生一定的不利影响。

（六）其他风险

1、对境外子公司的管控风险

公司于美国、德国、韩国、新加坡、中国香港、中国台湾等国家或地区设有控股子公司或分支机构，如果所在地国家和地区的监管政策、市场环境发生重大变化，或出现境内外经营理念的偏差，导致公司无法持续执行有效的境外子公司管控体系，可能对公司的生产经营产生不利影响。

2、公司境外子公司和分支机构司法辖区相关法律变化的风险

公司于美国、德国、韩国、新加坡、中国香港、中国台湾等国家或地区设有控股子公司或分支机构。如果公司的子公司和分支机构未能及时或完全遵守相关地区发布或更新的相关法律法规，则可能面临相应的法律风险，从而对公司的生产经营和财务状况造成不利影响。

3、公司规模扩张带来的管理和内控风险

随着资产规模与营收规模的快速增长，公司在研发、采购、生产、销售等环节上的资源配置和内控管理的复杂度也相应提升，从而对经营管理能力提出了更高要求。如果公司内控体系和管理水平无法及时适应规模扩张对经营管理各个层面的更高要求，则可能削弱其市场竞争力，将存在规模扩张带来的管理和内控风险。

4、产品和服务质量纠纷及其他纠纷的风险

若公司提供的产品和服务质量未能达到预期，公司在项目执行中未能严格按照内部控制制度和业务流程操作，或者公司未能按照法律、法规、合同或公司内部制度执行经营相关事项，公司将面临客户、员工或其他第三方投诉甚至引发与客户、员工或其他第三方的诉讼、仲裁风险，公司的经营情况和声誉可能因此受到不利影响。

四、重大违规事项

2025 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

（一）主要会计数据

2025 年度，公司主要会计数据如下：

单位：元

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减（%）
营业收入	5,076,317,948.58	4,632,977,839.11	9.57
利润总额	680,426,938.91	512,350,239.97	32.81
归属于上市公司股东的净利润	670,779,306.87	540,802,071.81	24.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	540,706,877.18	484,465,205.09	11.61
经营活动产生的现金流量净额	-294,917,595.40	682,274,724.36	-143.23
主要会计数据	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	8,916,417,247.80	5,914,723,200.11	50.75
总资产	11,383,768,568.78	9,952,915,308.70	14.38

（二）主要财务指标

2025 年度，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.24	0.20	20.00
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.20	20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.19	0.18	5.56
加权平均净资产收益率（%）	9.05	9.61	减少0.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.29	8.61	减少1.32个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	14.55	15.47	减少0.92个百分点

（三）主要会计数据及财务指标的变动原因

2025年，公司利润总额同比增长32.81%，主要原因系公司凭借核心技术优势，不断拓展各类产品的市场份额，收入持续增长并带动利润增长。

2025年，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少143.23%，主要系公司为业务的可持续增长提前储备关键存货所致。

2025年末，公司归属于上市公司股东的净资产较2024年末增长50.75%，主要系公司于2025年首次公开发行人民币普通股（A股）股票295,560,000股所产生的募集资金扣除发行费用后计入权益，及本期内增加的净利润所致。

六、核心竞争力的变化情况

公司主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售，公司依靠自主研发的核心技术，致力于为集成电路制造环节提供更先进处理能力和更高生产效率的集成电路设备。公司坚持植根中国的国际化经营战略，主要产品具有国际竞争力，并在核心技术积累、管理和技术团队、客户资源等方面具有核心竞争力，具体体现为：

（一）公司是具备多种集成电路设备研发生产能力的平台型集成电路设备公司，各产品在细分领域具有国际竞争力

公司已形成包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀及等离子体表面处理设备在内的三类具有国际竞争力的成熟集成电路设备产品线。公司是同时具备等离子体和晶圆快速热处理国际领先技术的集成电路专用设备公司，高产能真空晶圆传输设备平台可与公司各种反应腔体工程技术衔接，将助力公司加速进入一体化半导体设备市场，发展潜力巨大。

（二）公司已形成专业化、国际化的研发技术团队并具备核心技术积累

研发技术实力是公司能够持续改进现有产品并开发新产品的基石。公司坚持自主创新与自主知识产权开发，在中国、美国、德国等地设置研发中心负责新设备开发、成熟设备持续优化升级，科研成果在全球主要半导体生产地区申请专利保护，并且公司的各类设备多年来在国内外客户端的大量成功应用为公司积累了丰富的经验；公司在全球各地主要客户所在地配备了现场工艺工程师提供客户

端工艺开发、验证支持，本地化的产品研发及技术支持能力使公司能够快速响应客户对高端集成电路设备的定制化需求及技术服务需求。近年来公司依托长效激励机制、具有竞争力的薪酬福利、畅通的晋升渠道以及公司资源的优先倾斜，吸引了大量经验丰富的国内外半导体设备行业资深技术人才加入公司，截至报告期末，公司共有研发人员 397 人，占公司总人数的 31.26%，其中国内研发人员 276 人，占研发人员总人数的 69.52%，国内研发团队已成长为公司技术创新与产品开发的核⼼力量。

（三）公司拥有深耕行业多年、经验丰富的核心管理和技术团队

公司现任核心管理团队拥有集成电路领域知名企业多年从业经验，兼具国际化视野和对行业的深刻理解。公司核心技术人员在国际半导体设备行业耕耘二十年以上，拥有多项半导体设备先进工艺、技术、设计相关的发明专利，具备丰富的国际领先集成电路制造设备研发、制造、管理经验。

（四）公司拥有全球顶尖的客户资源

公司客户包括国内外领先的存储芯片制造厂商、逻辑电路制造厂商等，已全面覆盖全球前十大芯片制造商和国内行业领先芯片制造商。由于集成电路设备领域客户对于新产品生产效率、良率提升等要求较高，供应商验证周期长、替代成本高，因此下游客户稳定性较高。公司重要客户与公司建立了长期合作关系，客户资源优势明显。

（五）公司植根中国的国际化经营战略布局

公司在中国、美国、德国均有研发和制造基地，并在全球主要客户所在地都有本地化的销售服务团队，具有全球化研发、采购、制造、销售及服务优势，有助于公司将新产品向全球范围内的客户进行推广。公司在技术研发、全球化采购体系、产品制造、客户储备、市场拓展等领域积累了明显的先发优势和全球竞争力，境内外各研发和制造基地均具有成熟完备的产品研发、生产⼯艺流程、产品生命周期管理、供应链管理⼯经验，可服务全球客户。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

2025 年度，公司研发支出情况如下：

单位：元

项目	2025年	2024年	变化幅度（%）
费用化研发投入	738,597,459.51	716,893,959.24	3.03
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	738,597,459.51	716,893,959.24	3.03
研发投入总额占营业收入比例（%）	14.55	15.47	减少0.92个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

（二）研发进展

公司以半导体设备国际技术发展趋势、客户需求为导向，依靠具有丰富经验的国际化研发团队，形成以研发、生产、市场一体化的创新机制，取得了集成电路制造领域干法去胶、快速热处理、干法刻蚀及等离子体表面处理设备关键核心技术领域的重要成果，并在全球主要半导体生产国家及地区申请专利保护，把研发成果快速产业化。

2025 年，公司研发投入总额 7.39 亿元，同比增长 3.03%，研发投入总额占营业收入比例为 14.55%。2025 年，公司新增专利申请 61 项，其中发明专利 61 项，占比 100.00%；新增授权专利 85 项，其中发明专利 84 项，占比 98.82%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已申请专利 739 项，其中发明专利 737 项，占比 99.73%；已获授权专利 505 项，其中发明专利 503 项，占比 99.60%。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

2025 年，公司使用募集资金 234,286.73 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 234,286.73 万元，募集资金专户余额为 73.01 万元。募集资金使用情况如下：

单位：万元

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年7月3日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	249,748.20
其中：超募资金金额	-
减：发行费用	15,461.47
二、募集资金净额	234,286.73
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	234,286.73
累计使用募集资金金额	234,286.73
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	14.42
其他-尚未支付的发行费用	58.59
三、报告期末募集资金余额	73.01

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京屹唐半导体科技股份有限公司	兴业银行北京经济技术开发区支行	321130100100684767	4.56	使用中
北京屹唐半导体科技股份有限公司	中国工商银行北京经济技术开发区分行	0200316819100369546	62.75	使用中
北京屹唐半导体科技股份有限公司	招商银行北京亦庄支行	110920851710000	5.70	使用中

公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信

息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员直接持有的公司股份未发生变动，均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项

经核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，上市公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项。

十二、其他说明

本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、年度报告等信息披露文件。

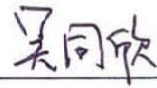
（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于北京屹唐半导体科技股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人签字：



魏 鹏



吴同欣

国泰海通证券股份有限公司

